

FALIT FS Laser Decapsulation System



功能/應用

激光開封裝是一種可以在不損害芯片整體功能的情況下局部去除模塑材料的技術。與化學開封裝技術相比，激光開封裝更有效，並減少暴露於強酸蝕刻的環境。

規格

橫截面激光切割模組:

型號: Draco-51S40A 綠色激光

波長: 532 納米

平均輸出功率: >10 瓦 在 40 千赫茲

脈衝寬度: <30 納秒 在 30 千赫茲

激光開封模組:

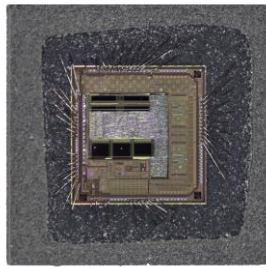
型號: Harrier-1064-14-L-V3 紅外線激光

波長: 1064 納米

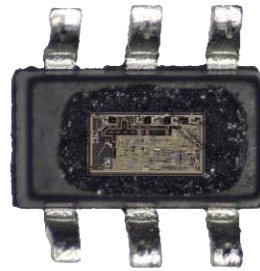
平均輸出功率: >12 瓦 在 10 千赫茲

脈衝寬度: <40 納秒 在 10 千赫茲

示例應用圖片



5x5 QFN 開封



SOT23-6 開封

設備製造商網頁

<https://www.controllaser.com/products/falit-failure-analysis-laser-inspection-tools-for-laser-decap-cross-sectioning-delidding/#one>

Youtube 演示視頻

https://www.youtube.com/watch?v=LIb__2FrT4s